

股票简称：扬杰科技

股票代码：300373



**扬州扬杰电子科技股份有限公司**

(江苏省扬州市维扬经济开发区)

**2020 年非公开发行股票预案**

二〇二〇年六月

## 公司声明

- 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
- 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
- 6、本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

## 特别提示

1、本公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第三十次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

3、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。最终发行价格由公司董事会根据股东大会授权在本次发行获得中国证监会的同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。

4、本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即141,635,067股。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息、回购行为，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

5、本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过150,000.00万元，在扣除发

行费用后实际募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目	138,000.00	130,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
	<b>合计</b>	<b>158,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

6、本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的上市公司股份在限售期届满后需按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

7、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布变化不会导致公司不具备上市条件，也不会导致本公司的控股股东和实际控制人发生变化。

8、为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

9、公司重视对投资者的持续回报，关于公司利润分配政策、最近三年现金分红金额及未分配利润使用情况、股东回报规划等情况，详见本预案“第五节 公司利润分配政策和现金分红情况”。

10、根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展

的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司制定本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施，公司控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺请参见本预案“第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，请投资者注意投资风险。

# 目 录

释 义 .....	7
第一节 本次非公开发行股票方案概要 .....	9
一、发行人基本信息 .....	9
二、本次非公开发行的背景和目的 .....	10
三、发行对象及其与本公司的关系 .....	13
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 .....	13
五、募集资金投资项目 .....	16
六、本次发行是否构成关联交易 .....	16
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....	16
八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 .....	16
九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .....	17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....	18
一、本次募集资金的使用计划 .....	18
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 .....	18
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .....	23
四、可行性分析结论 .....	23
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .....	25
一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况 .....	25
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....	25
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....	26
四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形 .....	26
五、本次发行对公司负债情况的影响 .....	26

第四节 本次股票发行相关的风险说明 .....	27
一、产业政策风险 .....	27
二、经营管理风险 .....	27
三、与募集资金投资项目有关的风险 .....	27
四、每股收益及净资产收益率下降风险 .....	28
五、半导体行业市场波动风险 .....	28
六、审批风险 .....	28
七、股票价格波动风险 .....	28
第五节 公司利润分配政策和现金分红情况 .....	29
一、公司的利润分配政策 .....	29
二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排 .....	32
三、公司未来三年的股东回报规划 .....	33
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 .....	37
一、董事会关于除本次发行外未来 12 个月内是否有其他股权融资计划的声明 .....	37
二、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及本公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施 .....	37

## 释 义

除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：

本公司、发行人、公司、扬杰科技	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司拟以非公开方式向特定对象发行股票
扬杰投资	指	江苏扬杰投资有限公司
杰杰管理	指	建水县杰杰企业管理有限公司，曾用名：扬州杰杰投资有限公司
本预案	指	公司本次非公开发行股票预案
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
定价基准日	指	本次非公开发行股票发行期首日
董事会	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
股东大会	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司股东大会
公司章程	指	扬州扬杰电子科技股份有限公司章程
元/万元/亿元	指	除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
半导体	指	导电性能介于导体和绝缘体之间的物质
半导体器件	指	通过对半导体中载流子运输和复合行为的控制而实现一定功能的产品。如：二极管、晶体管和集成电路等
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件，如：二极管、晶体管等
功率半导体、半导体功率器件	指	又称电力电子功率器件，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱点控制和强电运行间的桥梁。是半导体分立器件中的重要组成部分
芯片	指	经过半导体制备工艺加工后的晶圆片半成品，进一步通过封装测试可以形成半导体器件产品
集成电路、IC	指	将一定数目的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等集成在一起，从而实现电路或者系统功能的半导体器件。其英文缩写为IC
封装	指	晶圆制造后的一系列工序，即将晶圆分割成单个的芯片后，焊接引线并安放和连接到一个封装体上



测试	指	封装后对半导体器件功能、电参数等进行测量，以检测产品的质量
FBP	指	平面凸点式封装，Flat Bump Package
SOT	指	小外形晶体管，Small Outline Transistor
SOD	指	小外形二极管，Small Outline Diode
5G	指	第五代移动通信技术
K	指	半导体功率器件通用的数量单位千只，1 KK等于一百万只
IHS	指	IHS markit，一家提供全球商业资讯服务的市场研究公司

由于四舍五入的原因，本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在一定差异。

## 第一节 本次非公开发行股票方案概要

### 一、发行人基本信息

中文名称：扬州扬杰电子科技股份有限公司

英文名称：Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.

公司住所：江苏扬州维扬经济开发区

法定代表人：梁勤

成立时间：2006年8月2日

企业注册号：321000400012591

股本：472,116,893元

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称及代码：扬杰科技（300373）

董事会秘书：梁瑶

电话号码：0514-87755155

传真号码：0514-87943666

电子邮件：zjb@21yangjie.com

网址：<http://www.21yangjie.com>

经营范围：新型电子元器件及其它电子元器件的制造、加工，销售本公司自产产品；分布式光伏发电；从事光伏发电项目的建设及其相关工程咨询服务；光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发；光伏太阳能组件、太阳能应用工程零部件的销售；太阳能应用系统集成开发；道路普通货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 二、本次非公开发行的背景和目的

### （一）本次非公开发行的背景

#### 1、公司经营发展战略需要

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，产品广泛应用于消费类电子、安防、工业控制、汽车电子、新能源等诸多领域。凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力、丰富的客户资源以及稳定的产品质量优势，公司在半导体行业的诸多新兴细分领域已经取得领先的市场地位和较高的市场占有率，连续多年被中国半导体行业协会评为“中国半导体功率器件十强企业”。

随着下游产品和技术不断迭代，终端产品不断向小型化、轻薄化、高性能等趋势发展，市场对微型化集成电路和分立器件的需求不断提升，对于封装测试技术的应用需求不断提升。本次智能终端用超薄微功率半导体芯片封装测试项目的实施将进一步提升公司的封装测试能力，提升产能规模，不断适应市场竞争需求，巩固公司在半导体细分产业领域中的竞争地位，强化产业布局，提升市场竞争能力。

#### 2、半导体行业及智能终端领域需求巨大

根据全球半导体贸易统计组织数据显示，全球半导体行业2018年市场规模达到4,688亿美元，较2017年增长约13.7%；亚太地区半导体行业发展迅速，已成为全球最大的半导体市场，中国大陆地区属于全球半导体市场中增速较快的地区，2018年中国半导体产业市场规模达9,189.8亿元，同比增长16.5%，2013年至2018年，中国半导体市场规模复合增长17%以上<sup>1</sup>。在功率半导体方面，国内的产业链不断完善，技术不断进步，已经成为全球最大的功率半导体消费国，2018年市场需求规模达138亿美元，增速9.5%，占全球需求比例高达35%。随着全球贸易摩擦不确定性增加，加速进口替代成为必然趋势，也将为中国半导体产业发展带来新的机遇。根据IHS数据，2018年全球功率器件市场规模约为391亿美元，预计至2021年市场规模有望达到441亿美元，年复合增长率达到4.1%，我国功率半导体市场规模有望达到159亿美元，年复合增长率达到4.8%，超过全球功率半导体

<sup>1</sup> 数据来源：中国半导体产业发展状况报告（2019版）

增长速度。

根据中国工业和信息化部以及中国产业信息网的统计数据，2019年我国智能手机出货量合计3.72亿部<sup>1</sup>。随着5G技术的规模化商用，包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备等在智能终端产品也将迎来新一轮需求迭代，智能终端设备性能要求的提高将会进一步提高其中半导体产品的性能和用量需求，从而也会促进下游封装测试环节的需求增长。

### 3、国家政策重点支持半导体产业的发展

半导体产业（含半导体分立器件、集成电路、光电子器件等）是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的基础性产业，一直是国家政策重点支持的领域。国家通过技术鼓励、税收优惠、列入重点支持行业、设立产业基金、给予金融支持等诸多手段，对半导体产业进行扶持。近年来和半导体产业相关的主要政策如下：

序号	时间	政策名称	主要相关内容
1	2006年	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》	将核心电子器件、极大规模集成电路制造技术等列为发展专项内容。
2	2006年	《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》	重点围绕计算机、网络和通信、数字化家电、汽车电子、环保节能设备及改造传统产业等的需求，发展相关的片式电子元器件、机电元件、印制电路板、敏感元件和传感器、频率器件、新型绿色电池、光电线缆、新型微特电机、电声器件、半导体功率器件、电力电子器件和真空电子器件。
3	2009年	《电子信息产业调整振兴规划》	加快完善体制机制，改善投融资环境，培育骨干企业，扶持中小创新型企业，促进产业持续健康发展；加大财税、金融政策支持力度，增强集成电路产业的自主发展能力；实现电子元器件产业平稳发展；加快电子元器件产品升级；完善集成电路产业体系；在集成电路领域，鼓励优势企业兼并重组；继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。
4	2011年	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税；对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠

<sup>1</sup> 数据来源：Wind，工业和信息化部

5	2012年	《集成电路产业“十二五”发展规划》	集成电路产量超过 1500 亿块，销售收入达 3300 亿元，年均增长 18%，占世界集成电路市场份额的 15%左右，满足国内近 30% 的市场需求
6	2014年	《国家集成电路产业发展推进纲要》	明确了当前和今后一段时期是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。为此，我国成立国家层面的集成电路产业发展领导小组，设立集成电路产业投资基金，加大对集成电路产业的金融支持，鼓励集成电路企业在境内外上市融资；到 2015 年，集成电路产业销售收入超过 3,500 亿元，中高端封装测试销售收入占封装测试业总收入的比例要达到 30%以上；到 2020 年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过 20%，封装测试技术达到国际领先水平；到 2030 年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。
7	2015年	《中国制造（2025）》	突破大功率电力电子器件、高温超导材料等关键元器件和材料的制造及应用技术，形成产业化能力……着力提升集成电路设计水平……提升封装产业和测试的自主发展能力。
8	2016年	《国家信息化发展战略纲要》	打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破
9	2016年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》	大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，形成一批新增长点
10	2017年	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016年版）	明确集成电路、电力电子功率器件等电子核心产业的范围地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性新兴产业重点产品和服务
11	2018年	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	对满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策
12	2019年	《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》	依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在 2018 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。
13	2019年	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造等列为鼓励发展行业。

上述政策法规的出台和实施，为我国半导体产业的发展提供了良好的外部环境。

## （二）本次非公开发行的目的

本次非公开发行股票募集资金拟用于智能终端用超薄微功率半导体封测项目及补充流动资金。

本次非公开发行将为公司半导体产业的进一步发展提供资金支持，提升公司的综合竞争力。智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目是推动公司发展战略的需要，将提升公司封测技术，进一步开拓封装测试市场，增强公司在智能终端领域的市场竞争力，扩大产能规模，满足市场需求、提高市场份额，从而进一步增强公司的盈利能力；补充流动资金项目将为公司的可持续发展提供必要的资金，降低公司财务风险的同时满足公司各个环节对于资金的需求。

## 三、发行对象及其与本公司的关系

本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

截至本预案公告日，公司本次非公开发行股票尚无确定的对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。公司将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露发行对象与公司的关系。

## 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

### （一）本次发行股票的类型和面值

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

### （二）发行方式及发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

### （三）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

### （四）发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。

本次非公开发行价格的定价原则为不低于发行期首日前二十个交易日股票均价的80%。

其中：

发行期首日前二十个交易日股票交易均价=发行期首日前二十个交易日股票交易总额/发行期首日前二十个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次非公开发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本的数量， $P_1$ 为调整后发行价格。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情

况协商确定。

## **（五）发行数量**

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即141,635,067股。最终发行数量上限以中国证监会同意注册文件的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息、回购行为，本次非公开发行的股票数量及上限将进行相应调整。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据中国证监会同意注册文件的要求予以调整的，则本次非公开发行的股票数量届时将相应调整。

## **（六）限售期**

本次非公开发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

本次发行对象取得的上市公司股份在限售期届满后需按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

## **（七）上市地点**

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。

## **（八）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排**

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

## **（九）本次发行决议有效期**

本次非公开发行股票决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。



## 五、募集资金投资项目

本次募集资金总额不超过150,000.00万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目	138,000.00	130,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		<b>158,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

## 六、本次发行是否构成关联交易

目前，公司本次非公开发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的情形将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

## 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截止本预案公告日，扬杰投资持有本公司的股份比例为41.62%，为公司控股股东；杰杰管理持有本公司的股份比例为13.95%，为公司第二大股东，梁勤女士分别持有扬杰投资和杰杰管理82.48%、54%的股权，因此合计控制公司55.57%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，扬杰投资仍为公司控股股东，梁勤女士仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

## 八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件

本次非公开发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备

上市条件。

## 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次发行方案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。

本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

在获得中国证监会同意注册后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票呈报批准程序。

## 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

### 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过150,000.00万元，在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)
1	智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目	138,000.00	130,000.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		<b>158,000.00</b>	<b>150,000.00</b>

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

### 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

#### (一) 智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目

##### 1、项目基本情况

##### (1) 项目概况

公司拟使用本次募集资金130,000.00万元投资智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目，进一步完善公司产品结构、提高行业竞争优势。本项目将采用FBP平面凸点式封装、SOT小外形晶体管封装、SOD小外形二级管封装等封装技术，建成投产后将新增智能终端用超薄微功率半导体器件2,000KK/月的生产能力，所生产的功率器件产品可广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等，在智能手机及穿戴设备等智能终端领域以及5G通信、微波通信领域有着广泛应用。

##### (2) 项目实施单位

扬州扬杰电子科技股份有限公司。

### （3）项目投资概算

本项目计划总投资138,000.00万元，拟使用本次募集资金130,000.00万元用于该项目的建设，拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者银行贷款方式解决。

### （4）项目经济评价

本项目建设周期为3年，项目投产后，预计产能完全释放后正常年营业收入131,251.68万元，利润总额20,763.43万元，经济效益较好。

### （5）项目涉及报批事项

本项目建设位于扬州市邗江区。公司对本项目已展开前期准备工作，已完成项目的立项备案、环评等报批事项。

## 2、项目实施的必要性和发展前景

### （1）是国家半导体产业发展战略的需要

我国半导体产业发展较晚，与发达国际或地区相比，存在一定的差距，但是凭借庞大的市场，我国已经成为全球最大的半导体消费国，因此，提升我国半导体产业链各环节的竞争力，加快应用市场的发展，在国际贸易争端不确定性的背景下，满足半导体产业进口替代的需求愈发明显。

半导体产业作为全球科技发展的前沿，产业链各环节都属于高技术密集型产业，但相对而言，封装测试因技术壁垒相对较低、劳动力成本要求较高和资本壁垒较高的特点，因此该环节成为我国半导体行业发展的突破口，也是国内半导体产业与世界先进水平更为接近的环节。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确要求到2020年封装测试技术达到国际领先水平。

### （2）是公司提升产品竞争优势，强化产业布局的需要

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，产品广泛应用于消费电子、安防、工业控制、汽车电子、新能源等诸多领域。凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力、丰富的客户资源以及稳定的产品质量优势，公司在半导体行业的诸多新兴细分领域已经取得领先的市场地位和较高的市场占有率，连续多年被中国半导体

行业协会评为“中国半导体功率器件十强企业”。

因终端产品不断向小型化、轻薄化、高性能等趋势发展，市场对微型化集成电路和分立器件的需求不断提升，先进的封装测试技术在半导体产业链中的重要性越发突出。公司本次募集资金投资的智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目将进一步提升公司在功率半导体领域的微型封装优势，封装产品尺寸体积小、重量轻、电热性能优等特点更为显著，在智能手机、平板电脑、可穿戴设备等便携式智能终端领域技术优势更加明显。本次募投项目的顺利实施将进一步优化公司的产品结构，提升产品竞争优势，完善产业布局的战略目的，从而扩大公司产品市场份额和行业竞争地位。

### **(3) 是公司满足市场需求，应对市场竞争的需要**

公司所处的半导体行业发展迅速，市场化程度高，市场竞争激烈，技术和产品更新换代较快，根据下游客户和终端消费者的需求，需要不断提升技术优势和产品质量优势。公司产品定位于中高端市场和进口替代，直面台资、外资品牌的竞争，需要在产品研发、市场定位、产业布局方面不断适应市场变化。

与此同时，随着产品的升级迭代，对终端应用技术的要求随之提升，将带动产业技术的更迭与提升，从而促进产品升级换代形成新一轮需求。因此，面对下游市场的产品及技术需求，公司加大布局产业前沿、扩大技术和质量优势，将会在新一轮市场竞争中取得先发优势，巩固市场地位，扩大市场份额。

## **3、项目实施的可行性**

### **(1) 国家产业政策大力支持行业发展**

2006年，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中将核心电子器件、极大规模集成电路制造技术等列为发展专项内容。2011年，《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》要求对符合条件的集成电路封装、测试、关键专用材料企业以及集成电路专用设备相关企业给予企业所得税优惠。2014年，《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确到2020年封装测试技术达到国际领先水平；2014年，国家集成电路产业投资基金一期募资规模超过1,000亿元，重点投资集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计，封装测试设备和材料等产业；2016年，战略新兴产业和信息化的“十三五”规划，要求大力发展芯片级封装、圆片

级封装等研发和产业化进程，推动封装测试等产业快速发展；2018年，《政府工作报告》指出加快制造强国建设，推动集成电路等产业发展；2019年，国家集成电路产业投资基金二期募资规模超过2,000亿元，进一步推进国家对集成电路产业发展的战略引导和支持作用。

## （2）下游市场空间巨大

根据IHS数据，2018年，全球功率半导体市场规模达到391亿美元，同比增长5.9%，我国功率半导体市场规模达到138亿美元，占据全球功率半导体市场的35%。2021年全球功率半导体市场规模有望达到441亿美元，复合增长率达到4.1%，我国功率半导体市场规模有望达到159亿美元，年复合增长率达到4.83%，超过全球功率半导体增长速度。

2019年6月，国家工信部正式向三大运营商及中国广电颁发5G商用牌照，5G基础设施建设及应用不断加速，5G将驱动相关产业的增长。根据IHS预计，5G将会给全球市场带来12万亿美元的经济增量，而与手机市场相关的信息通讯将占增量的12%，排名第二。根据市场调研公司Canalys预计，从2020年开始5G手机市场将开始快速攀升，将在2023年迎来拐点，市场份额超过50%，从而超越4G手机成为市场主流，2023年总计会有19亿部5G设备活跃在全球市场。在各个地区的市场情况来看，中国将成为最大的5G市场，预计出货量将占据全球的34%。除手机市场外，5G的应用也将推动平板电脑、可穿戴设备等智能终端产品的迭代增长。

## （3）公司具备实施的项目条件

公司在半导体行业长期经营积累中，在技术研发方面、市场营销方面等方面已经形成了丰富的力量储备和竞争优势。

在研发技术方面，公司持续加强研发创新，截至2020年3月31日，公司拥有研发人员600余人，占公司总人数的比例超过25%，拥有国家专利255项，其中发明专利43项，拥有丰富的研发人员和较为高端的研发中心，并不断加强优质人才储备，在先进封装研发设计等方面形成了高质量的人才队伍和研发力量，已经具备了自行完成智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目的实施能力。

在市场营销方面，依托公司良好的技术研发能力及严格的质量管理体系，公

公司在多年的市场经营中，积累了较为丰富的客户资源，赢得了较好的市场口碑，形成了较强的客户可持续开发能力。同时，在智能终端用超薄微功率半导体芯片封测方面，公司已对行业和市场进行了较为详细的调研，公司已有的生产组织、物流运输、营销团队能够较好地完成相关产品的市场开拓工作，全球化的营销网络也将保证公司产能的消化。

综上，公司已经具备了实施智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目的条件。

## （二）补充流动资金项目

### 1、项目基本情况

公司拟使用本次募集资金的20,000.00万元补充流动资金。

### 2、项目实施的必要性和可行性

#### （1）公司业务发展对流动资金的客观需求

公司主要从事半导体分立器件的研发、生产与销售，受国家宏观政策和国内需求的影响，市场前景广阔，产品销售情况良好，公司销售收入持续增长，2018年公司营业收入185,178.35万元，2019年公司实现营业收入200,707.50万元，较上年增长8.39%。随着公司业务规模的不断扩大，公司需投入大量营运资金进行材料采购、产品生产、市场营销等经营活动。

公司拟通过本次募集资金投资建设“智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目”产能完全释放后，将对公司营运资金提出更高要求。为实施本次募集资金投资项目，公司已经开始前期投入，使用自有资金购买生产经营用土地。

充足的营运资金是公司业务发展的内在需求和重要资源保障，公司营运资金得到补充后，将有利于改善公司财务结构，提高资产的流动性，从而抓住市场机遇，巩固市场份额，提升公司的综合竞争力。

#### （2）持续增加的研发投入对营运资金的需求

公司秉持创新发展的理念，注重在技术与产品研发上的投入，通过引进高技术人才、强化与科研院所的合作关系、加强研发团队及研发平台的建设、构建科学的产品研发流程及高效的研究开发体系等方式，不断强化自己的研发能力和技

术水平。2019年，公司研发总投入金额为9,968.82万元，较2018年增长3.54%，占营业收入的比例4.97%。

本次募集资金投资项目中，公司将进一步加大研发投入，大力引进经验丰富的高层次人才，加强与专业高校、科研院所的深度合作，积极开发新技术、新产品。公司研发工作的推进、研发体系的维持及未来产业化项目的实施，均需要充足的流动资金作为保障。

### **(3) 优化资本结构，降低财务风险**

截至 2020年3月31日，公司合并报表的资产负债率为26.49%，通过本次非公开发行股票募集资金，公司资产结构将得到进一步优化，财务风险将有效降低。

对于该项流动资金的管理运营安排，公司将严格按照《募集资金管理制度》，根据业务发展的需要使用该项营运资金。公司在进行该项流动资金使用时，资金支出将严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

## **三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响**

### **(一) 对公司经营管理的影响**

本次非公开发行完成后，公司在智能终端用超薄微功率半导体芯片的封测能力得到提升和加强，适应下游产品和技术迭代的需求。因此，从公司经营管理的角度，本次发行募集资金的运用有利于进一步巩固公司市场竞争优势，促进公司可持续发展。

### **(二) 对公司财务状况的影响**

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模均将大幅度提升，募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加。由于募集资金投资建设周期的存在，短期内募集资金投资项目对公司经营业绩的贡献程度将较小，可能导致公司每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄。

## **四、可行性分析结论**

本次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策及行业发展方向，募集资金投资项目具有良好的发展前景和盈利能力，有利于有效推进公司的发展战略，



有利于进一步扩大公司的业务规模，提升公司的市场竞争优势和行业地位，增强公司综合实力，符合公司及全体股东的利益。

### **第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析**

#### **一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况**

##### **(一) 本次发行后公司业务及资产整合计划**

本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后，公司将提升智能终端用超薄微功率半导体芯片的封测能力，加强公司产品和服务的行业竞争力。本次发行后公司业务有所扩大，不涉及资产整合问题。

本次非公开发行完成后，公司的总资产规模、净资产规模均将较大幅度增加。

##### **(二) 对公司章程的影响**

本次非公开发行完成后，公司股本总额及股权结构将发生变化，公司将根据本次发行的实际情况对公司章程中的相关条款进行修订并办理工商变更登记。

##### **(三) 对股权结构、高级管理人员结构、业务结构的影响**

本次非公开发行完成后，公司原股东持股比例将相应变化，但不会导致公司控制权发生变化，公司高级管理人员结构亦不会因本次发行发生变动。公司主营业务产品结构、客户结构、市场结构将得到进一步优化，有助于提升公司的市场竞争力。

#### **二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

本次非公开发行完成后，公司的总资产、净资产规模均将较大幅度提升，整体资产负债率水平得到降低，公司资金实力得到增强，为公司可持续发展奠定基础。募集资金投资项目实施后，公司营业收入规模及利润水平也将有所增加，盈利能力将进一步增强。

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流量将大幅增加；并且，在本次募集资金开始投入使用之后，公司的投资活动现金流量将相应增加。在本次拟投

资项目建成投产并产生效益之后，公司的经营活动现金流量将相应增加，整体盈利能力将得到进一步增强。

### **三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易、同业竞争情况均不会因本次发行而发生变化。

### **四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形**

公司不会因本次非公开发行产生公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不会增加为控股股东及其关联人提供担保的情形。

### **五、本次发行对公司负债情况的影响**

截至2020年3月31日，公司资产负债率（合并报表口径）为26.49%，本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公司资产总额和净资产总额都有所提升，资产负债率有所下降，降低了公司的运营风险和财务风险。

## 第四节 本次股票发行相关的风险说明

投资者在评价公司本次非公开发行股票时，除预案提供的各项资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素：

### 一、产业政策风险

本次募集资金投资项目均属于半导体行业，国家相关产业政策有利于行业的发展，相关利好政策为项目的盈利和可持续发展带来良好的预期。但如果未来国家在半导体产业方面的政策有所调整，将会导致项目前景发生重大变化，为项目的盈利带来风险。

### 二、经营管理风险

本次非公开发行投资项目实施以后，公司资产规模、业务规模等都将进一步扩张，对公司研究开发、生产组织、人才储备、运营管理、财务管理、市场开拓、内部控制等方面的管理提出更高要求。如果公司经营管理能力不能适应公司扩张的要求，管理模式未能随着公司资产和业务规模的扩大及时调整完善，将会削弱公司的市场竞争能力，引起扩张带来的经营管理风险。

### 三、与募集资金投资项目有关的风险

#### （一）募投项目产能消化的风险

本次募集资金投资项目中智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目将提高公司相关产品的封装测试能力和产能规模，适应下游产品和技术迭代的竞争需求。虽然公司已经对募集资金投资项目的可行性进行了较为充分地分析和论证，对募集资金投资项目新增产能的消化做了充分准备。但如果市场需求增速低于预期或公司市场开拓不力，将对募集资金使用效益产生不利影响。

#### （二）募投项目新增折旧、摊销影响公司业绩的风险

本次募投项目建成后，每年新增折旧、摊销费用金额较大，本次募投项目投产初期，生产负荷较低，经济效益较少，从而新增折旧、摊销将对公司的经营业绩产生一定影响。

## 四、每股收益及净资产收益率下降风险

本次非公开发行完成后，公司资产规模将有所增加，虽然募集资金投资项目的实施预期将会提升公司的盈利能力，但由于募集资金投资项目建设周期的存在，且募集资金投资项目的效益释放需要一定时间，短期内募集资金投资项目的投入可能导致公司每股收益和净资产收益率被摊薄。

## 五、半导体行业市场波动风险

全球宏观经济的发展对半导体产业的市场需求形成一定的影响，2019年世界范围内贸易争端不断、中美贸易争端持续升级，2020年新型冠状病毒肺炎的全球性爆发都对世界经济发展产生重要影响，进而影响全球半导体产业需求。如果未来全球经济不能较好发展，半导体市场需求存在波动的风险，将影响公司经营及本次募投项目效益的实现。

## 六、审批风险

本次非公开发行股票尚需公司股东大会审议批准，本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。另外，本次非公开发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，能否取得有关主管部门的批准，以及最终取得批准的时间均存在不确定性。

## 七、股票价格波动风险

本公司股票价格可能受到国家政治、经济政策以及投资者心理因素及其他不可预见因素等系统风险的影响，股价的变动不完全取决于公司的经营业绩，投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑到市场的各种风险。

## 第五节 公司利润分配政策和现金分红情况

### 一、公司的利润分配政策

本次发行前后公司的股利分配政策不存在重大变化。

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，在《公司章程》中对有关利润分配政策的事宜进行了约定，完善了利润分配的决策程序和机制。《公司章程》中公司利润分配政策如下：

“第一百五十条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

第一百五十一条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百五十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十三条 公司的税后利润按下列顺序分配：

- （1）弥补亏损；
- （2）提取法定公积金；
- （3）提取任意公积金；
- （4）支付股东股利。

公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大会批准。

公司在弥补亏损和提取法定公积金前，不得分配利润。

公司利润分配应遵循以下规定：

1、公司实施积极的利润分配政策，利润分配不得损害公司持续经营能力，不得超过累计可分配利润的范围。

公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。

公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。

董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

公司应每年至少进行一次利润分配。公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红优先于股票股利分配方式。

公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。

公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

- ① 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过

公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000 万元；

② 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。

2、利润分配预案由董事会提出，并经股东大会审议通过后实施。

年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。如果年度盈利而公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、公司留存资金的使用计划和安排，独立董事应当对此发表独立意见，同时，监事会应当进行审核，并提交股东大会审议；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应为股东提供网络投票方式。

股东大会作出利润分配决议后，董事会应当在股东大会召开后两个月内完成利润分配方案。

3、公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司应在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。股东大会表决时，应安排网络投票。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事1/2以上同意。

4、公司应当制定分红回报规划和最近五年的分红计划。公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与公司章程的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。



5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

（二）分红标准和比例是否明确和清晰；

（三）相关的决策程序和机制是否完备；

（四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

## 二、公司近三年现金分红情况和未分配利润使用安排

### （一）公司近三年利润分配情况

#### 1、2017年度利润分配情况

2018年4月23日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案。具体方案为：以公司现有总股本472,262,993股为基数，向全体股东每10股派1.24元人民币现金（含税），共计派发现金红利5,856.06万元（含税）。

#### 2、2018年度利润分配情况

2019年5月17日，公司召开的2018年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案。具体方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后470,271,393股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利9,438.42万元（含税）。

#### 3、2019年度利润分配情况

2019年4月9日，根据2018年第三次临时股东大会授权，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议修订了回购部分社会公众股份的预案，于2019年1月23日首次回购公司股份至2019年8月30日实施完毕，以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,640,322股，占公司总股本的0.7710%，合计金额为5,493.19万元。

2019年9月9日，公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了2019年半年度权益分派方案。具体方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后468,492,971股为基数，向全体股东每10股派0.55元人民币现金（含税），共计派发现金红利2,571.69万元（含税）。

2020年5月11日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了2019年年度权益分派方案。具体方案为：以截至2020年4月16日扣除回购专户中已回购股份后的总股本470,846,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元人民币（含税），共计派发现金红利4,143.45万元（含税）。

公司近三年的现金分红情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度
现金分红金额（含税）（含回购）	5,856.06	9,438.42	12,208.32
归属于母公司所有者的净利润	26,655.69	18,738.27	22,515.29
现金分红额/当年净利润	21.97%	50.37%	54.22%
最近三年累计现金分红	27,502.80		
最近三年年均净利润	22,636.42		
最近三年累计现金分红/最近三年年均净利润	121.49%		

## （二）未分配利润使用安排

公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业务规模的同时，积极拓展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东利益最大化。

## 三、公司未来三年的股东回报规划

为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，公司制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：

### （一）本规划制定原则

本规划的制定应在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考

考虑对投资者的回报，认真听取投资者（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

## （二）公司制定本规划考虑的因素

本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的安排。

## （三）公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的具体内容

1、分配方式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红优先于股票股利分配方式。

2、分配周期：公司应每年至少进行一次利润分配，公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求提议进行中期分红。

3、分配比例：公司现金分红不少于当年实现的可分配利润的20%。

未来三年（2020-2022年），公司董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过5,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

#### **(四) 股东回报规划的决策机制**

1、公司的利润分配政策的制定和修改由公司董事会提出，提交股东大会审议。董事会提出的利润分配政策需要经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订发表独立意见。

2、公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审核，并且经半数以上监事表决通过。

董事会、监事会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事、公众投资者的意见。

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会应为股东提供网络投票方式。

#### **(五) 股东回报规划的制定与调整及决策机制**

##### **1、股东回报规划的制定与调整**

公司应当制定分红回报规划和最近五年的分红计划。公司可以根据股东（特别是中小股东）、独立董事和外部监事的意见对分红规划和计划进行适当且必要的调整。调整分红规划和计划应以股东权益保护为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触，公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

##### **2、股东回报规划调整的决策机制**

公司调整或变更股东回报规划应由董事会作出专门审议，详细论证调整或变

更理由，对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明，在独立董事对股东回报规划的调整或变更发表独立意见后，提交股东大会以特别决议通过。

## 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项

### 一、董事会关于除本次发行外未来 12 个月内是否有其他股权融资计划的声明

根据公司未来发展规划、行业发展趋势，考虑公司的资本结构、融资需求以及资本市场发展情况，除本次非公开发行外，本公司将根据业务情况确定未来12个月内是否安排其他股权融资计划。

### 二、本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响及本公司董事会作出的关于承诺并兑现填补回报的具体措施

#### （一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次发行方案实施后，公司股本数量将较发行前有所增加，公司净资产规模也将大幅提高，由于本次非公开发行募集资金投资项目存在一定的建设周期，项目建设期内的经济效益及股东回报需要一定时间实现。因此，短时间内存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险。

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、假定本次非公开发行于2020年11月实施完毕，该完成时间仅为假设估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为22,515.29万元，假设2020年度实现的归属于上市公司股东的净利润分别较2019年减少10%、持平、增长10%三种情况（前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

3、公司本次非公开发行股份不超过141,635,067股，假设以发行股份141,635,067股进行测算；本次非公开发行募集资金总额为不超过150,000.00万元，

假设不考虑发行费用，以募集资金上限150,000.00万元进行测算。本假设不对本次非公开发行的价格、发行数量、募集资金总额做出承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

4、在预测公司净资产时，仅考虑募集资金、净利润、2019年度现金分红、2020年3月回购的影响，未考虑除上述因素之外的其他因素对净资产的影响。

5、在预测2020年末发行前后总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行股票及2020年1季度回购注销第二期限限制性股票激励计划3名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计16,400股的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜。

6、本测算在假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

7、本次非公开发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会同意注册发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况和公司业务状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

基于上述假设前提，公司测算了不同盈利假设情形下本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2019年度/ 2019年12月31日	2020年度/2020年12月31日	
		剔除非公开发行的影响	考虑非公开发行的影响
股本总额（股）	472,133,293.00	472,116,893.00	613,751,960.00
本次非公开发行募集资金总额（元）		1,500,000,000.00	
预计本次发行完成的月份		2020年11月	
当年期初归属于母公司股东所有者权益（元）	2,403,202,239.67	2,543,425,835.45	

假设情形 1:2020 年净利润比 2019 年度持平			
当年度归属于母公司所有者净利润（元）	225,152,908.48	225,152,908.48	
期末归属于母公司所有者权益合计（元）	2,543,425,835.45	2,727,033,247.96	4,227,033,247.96
基本每股收益（元/股）	0.48	0.48	0.47
加权平均净资产收益率（%）	9.16%	8.56%	8.17%
假设情形 2:2020 年净利润与 2019 年度下降 10%			
当年度归属于母公司所有者净利润（元）	225,152,908.48	202,637,617.63	
期末归属于母公司所有者权益合计（元）	2,543,425,835.45	2,704,517,957.11	4,204,517,957.11
基本每股收益（元/股）	0.48	0.43	0.42
加权平均净资产收益率（%）	9.16%	7.73%	7.38%
假设情形 3:2020 年净利润比 2019 年度增长 10%			
当年度归属于母公司所有者净利润（元）	225,152,908.48	247,668,199.33	
期末归属于母公司所有者权益合计（元）	2,543,425,835.45	2,749,548,538.81	4,249,548,538.81
基本每股收益（元/股）	0.48	0.52	0.51
加权平均净资产收益率（%）	9.16%	9.37%	8.95%

如上表所示，在完成本次非公开发行后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产将增加，根据上述测算，如果盈利能力未能获得相应的增长，本次非公开发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年同期出现下降。本次融资募集资金到位当年（2020年度）公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。

## （二）本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司的股本规模和净资产规模将有较大幅度增加，由于募集资金投资项目的实施和产生经济效益需要一定的时间，因此短时间内公司的每股收益和净资产收益率等指标有所下降，即期回报存在被摊薄的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。此外，若本次发行的募集资金不能实现预期效益，也将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

## （三）本次非公开发行的必要性和合理性

本次非公开发行募集资金投资项目用于公司主营业务，有利于公司扩大产能，提高行业地位，优化产品结构，增强公司核心竞争力及盈利能力。本次募集资金



投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和未来发展战略，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及公司全体股东的利益。关于本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和合理性分析，请见本预案第“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

#### **（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

##### **1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系**

公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展，近年来公司客户、产品结构不断优化，主营业务未发生重大变化。目前公司已经掌握了一系列中高端封装测试技术，本次募集资金投资项目中智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目将围绕公司主营业务，进一步将先进的功率半导体芯片封测业务产业化、规模化，符合公司经营发展战略，有利于提升公司市场竞争力、行业地位和整体盈利能力。

##### **2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况**

人员储备方面，公司的核心管理团队和技术研发团队均长期从事功率半导体相关业务，在生产管理、技术研发、财务管理领域拥有丰富的经验，专业优势明显。公司通过“潜龙计划”面向985、211院校开展校招人才招聘工作，并且陆续引进业内资深人才，为公司提供了优质的人才储备，为本次非公开发行募投项目的实施奠定了坚实的人才基础。

在技术储备方面，公司已是国内少数集单晶硅片制造、芯片设计制造、器件设计封装测试、终端销售与服务等纵向产业链为一体的规模企业，系“中国办公提功率器件十强企业”。截至2020年3月31日，公司已有国家专利255项，其中发明专利43项，研发人员占比超过25%，建有国内较高端的研发中心并配有先进的研发测试设备，形成了从售前技术支持到售后技术服务的完备的研发及技术服务体系，为公司新品开发、技术瓶颈突破、开拓市场提供了技术支撑，也为本次非公开发行募投项目的实施提供了技术储备。

在市场储备方面，凭借长期的技术积累、持续的自主创新能力和成熟完善的

市场营销网络，已经形成了较为领先的市场竞争优势，在诸多新兴细分市场领域具有领先的市场地位和较高的市场占有率。公司目前实行“YJ”和“MCC”双品牌营销模式，在欧美市场，公司主推具有美资背景的MCC品牌，与DIGI-KEY、Arrow集团、Future 集团、Mouser等全球知名通路商进行合作，充分利用其丰富的营销渠道；同时，在美国、德国、法国、土耳其、意大利等地设立交付服务中心，积极开拓当地及周边市场，持续提升MCC品牌在国际市场的占有率。在亚洲市场，公司主推YJ品牌，通过前线铁三角与后方研发技术、交付大平台相联动的销售模式，直接开发行业TOP大客户，并与大客户达成战略合作伙伴关系，同时，在亚洲设有多个营销网点和物流仓库，以确保产品的快速交付，并为客户及时提供技术服务。为本次非公开发行募投项目的实施提供了市场储备，保证了新增产能可以被合理消化。

综上，公司本次募投项目在人员、技术、市场等方面储备情况良好。

## （五）公司关于填补即期回报的具体措施

考虑到本次非公开发行股票可能导致原股东的即期回报被摊薄，公司将采取多种措施以提升公司的经营业绩，采取的具体措施如下：

### 1、加快募集资金投资项目建设进度，强化募集资金管理

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及公司整体战略规划，项目完成后将进一步提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快项目建设进度，统筹安排，快速推进，争取早日完成项目建设、达产并实现预期收益，增加股东回报。

公司已按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及相关规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、监管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定期对募集资金进行内部审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

### 2、加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的公司治理结构，夯实了公司经营管理和内部控制的基础，未来公司将进一步提高经营管理水平。

为提升公司的盈利能力，削弱本次发行摊薄即期回报对股东的影响，公司将在原有内部控制的基础上，进一步加强企业内部管控，对公司内部资源配置、运营管理、资金管理等环节进一步梳理，加强成本管理，全面控制公司经营和管理风险，提升经营效率和盈利能力。

### **3、严格执行利润分配政策，保证股东利益回报**

为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策的透明度，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》及中国证监会的相关规定在《公司章程》中明确了分红政策，并制定了相关分红回报规划。本次非公开发行股票完成后，公司将继续严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制，切实维护投资者合法权益。

本次非公开发行股票完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。

公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

## **（六）相关主体对本次发行摊薄即期回报的相关承诺**

### **1、公司控股股东、实际控制人的承诺**

为保证公司本次非公开发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司控股股东扬杰投资、实际控制人梁勤分别作出以下承诺：

（1）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

(3) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## **2、公司董事、高级管理人员的承诺**

为保证公司本次非公开发行股票涉及的摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员分别作出以下承诺：

(1) 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

(2) 勤勉尽责，严格按照公司内控管理要求，避免不必要的职务消费行为，并积极配合审计部等相关部门的日常检查工作；

(3) 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

(4) 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(5) 若公司未来开展股权激励，则股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

(6) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（本页无正文，为《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》之签章页）

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日